

令和7年度

京都実装技術研究会 オープニングセミナー

京都実装技術研究会は、昭和62年に発足し、電子機器の生産に深く関わる基盤技術である接合・実装技術を中心に、生産現場の高度化のために必要な課題や各社が抱えている共通の問題をテーマにした活動を行い、参加企業の技術水準向上に努めています。

この度、令和7年度の会員募集に先立ち、参加費無料のオープニングセミナーを以下のとおり開催します。

- ◇ 開催日時 令和7年6月13日（金） 13:30 ~ 16:30
- ◇ 開催方式 会場／Web参加 併用（講師は会場でのご講演です）
- ◇ 会場 京都府産業支援センター 5階 研修室
（京都市下京区中堂寺南町134 京都リサーチパーク東地区内）
- ◇ 内 容

2nmロジック半導体を巡る攻防

一開発とは何か、量産とは何か、歩留りとは何か一

最先端のロジック半導体においては、TSMC、Samsung、IntelおよびRapidusが、2nm相当のテクノロジーノードの開発と量産を競っている。講演では、半導体の「開発とは何か」、「量産とは何か」、「歩留りとは何か」を定義した上で、上記4社の現在地を明らかにする。

講師：微細加工研究所 所長 湯之上 隆 様

1961年静岡県生まれ。87年京都大学 工学研究科修士課程修了。日立製作所入社。以降16年にわたり、日立製作所中央研究所、半導体事業部、デバイス開発センター、エルピーダメモリ（出向）、半導体先端テクノロジーズ（出向）にて、半導体の微細加工技術開発に従事。その後、大学にて半導体産業の社会科学研究に従事。00年工学博士の学位取得(京都大学)。現在は微細加工研究所の所長として、半導体関連のコンサルタントおよびジャーナリストとして活躍中。

※講習後は懇親会も開催します（会費は研究会より補助します）

- ◇ 定 員 会場：40名 Web：40名
- ◇ 参 加 費 無料
- ◇ 申込締切 令和7年6月11日（水）まで
※懇親会にご参加される場合は6月5日（木）までにお申し込みください。

- ◇ 申込方法 当センターホームページからお申し込みいただけます。
(<https://www.kptc.jp/kenkyukai/250613jisso/>)
※E-mail 又は F A X でもお申し込みいただけます。

- ◇ 問合せ先 京都府中小企業技術センター 応用技術課 電気通信係
(京都実装技術研究会事務局)
TEL 075-315-8634 FAX 075-315-9497
E-mail jisso@kptc.jp

令和7年度 京都実装技術研究会 オープニングセミナー申込書

会社名					
所在地					
連絡担当者	所属・役職				
	氏名				
	E-mail				
	電話番号				
	参加方法	☐ 会場 ☐ Web ☐ 連絡のみ担当（本人は不参加）			
	懇親会	☐ 参加 ☐ 不参加			
参加者	所属・役職	氏名	E-mail ※個別連絡も希望する場合は記入	参加方法	懇親会
				☐ 会場 ☐ Web	☐ 参加 ☐ 不参加
				☐ 会場 ☐ Web	☐ 参加 ☐ 不参加
				☐ 会場 ☐ Web	☐ 参加 ☐ 不参加
				☐ 会場 ☐ Web	☐ 参加 ☐ 不参加

※懇親会へのご参加を希望される場合は6/5（木）までにお申し込みください。

（期限後にご連絡いただいた場合は、会場手配の都合上、参加をお断りする場合があります）

※申込書に御記入いただいた個人情報は、本研究会受講者名簿として活用させていただきます。

受講に当たっての注意点

- Web参加は、1事業所1接続でお願いします。複数名で参加される場合は、プロジェクターやスピーカー等のご準備をお願いします。
- 録画、録音等の配信データの記録、保存は一切禁止です。
- 会場には消毒液を設置し、会場の窓や扉の開放等による換気、他の受講者との間隔をあける等の対策をいたします。ご来所の際は手洗いか手指消毒をお願いします。また、発熱等の症状がある方はご来場をお控えください。